

2022年3月期 第2四半期決算

2021年11月10日

 **丸文株式会社**

東証1部 7537

アジェンダ

1. 2022年3月期 第2四半期 連結決算の概要

2. 中期経営計画の取組み状況

3. 2022年3月期 業績予想の概要

4. 株主還元

5. 参考資料

2022年3月期 第2四半期 連結決算の概要

2022年3月期 第2四半期 業績サマリ

■ 市場が回復。中期経営計画の各種施策も進み、期初業績予想を大幅に上回る

(百万円)	21/3月期 上期 (従来基準)		22/3月期 上期 (従来基準)			前年同期比 (従来基準)		予想比 (従来基準)	22/3月期 上期 (収益認識基準)
	実績	構成比	予想 (5/14時点)	実績	構成比	金額	%	金額	実績
売上高	137,268	100.0%	109,500	147,356	100.0%	+ 10,088	7.3%	+ 37,856	80,574
デバイス事業	118,982	86.7%	89,000	124,097	84.2%	+ 5,115	4.3%	+ 35,097	57,900
システム事業	18,285	13.3%	20,500	23,260	15.8%	+ 4,975	27.2%	+ 2,760	22,674
売上総利益	6,905	5.0%	7,300	9,528	6.5%	+ 2,623	38.0%	+ 2,228	9,417
販管費	7,484	5.5%	6,700	6,841	4.6%	△ 643	-8.6%	+ 141	6,841
営業利益	△ 579	-	600	2,686	1.8%	+ 3,265	-	+ 2,086	2,575
営業外収益	993	0.7%	125	80	0.1%	△ 913	-91.9%	△ 45	80
営業外費用	395	0.3%	265	598	0.4%	+ 203	51.4%	+ 333	551
経常利益	18	0.0%	460	2,168	1.5%	+ 2,150	11944.4%	+ 1,708	2,104
特別利益	-	0.0%	0	21	0.0%	+ 21	-	+ 21	21
特別損失	116	0.1%	0	4	0.0%	△ 112	-96.6%	+ 4	4
親会社株主に帰属する 当期純利益	△ 64	-	230	1,319	0.9%	+ 1,383	-	+ 1,089	1,256

■ ポイント（前年対比：従来基準ベース）

売上高	(デバイス事業) 民生機器・PC周辺機器向け半導体が増加 (システム事業) 産業機器・レーザ機器が増加
売上総利益	相対的に利益率の高い商材の伸長により売買差益が増加
営業利益	売上総利益の増加および人件費の減少による増加
経常利益	為替差損327百万円（前期は為替差益867百万円）を計上
当期純利益	前期は特別退職金102百万円を計上

2022年3月期 第2四半期 『デバイス事業』 品目別売上高

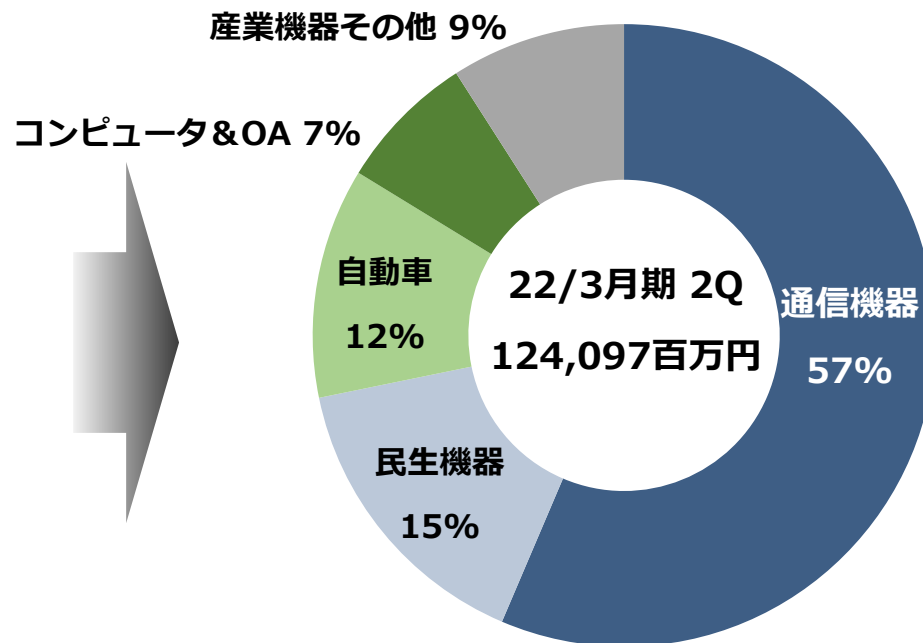
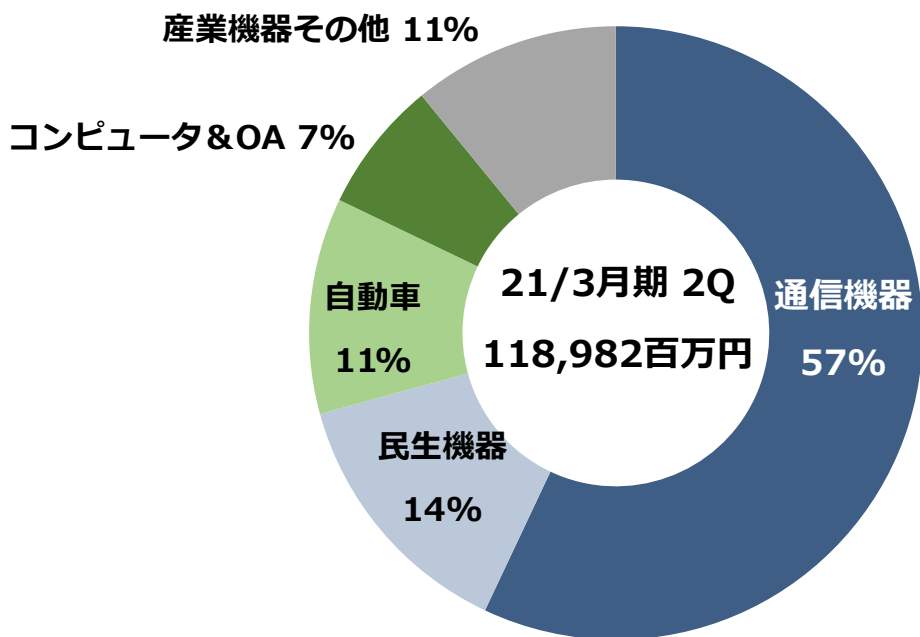
■ PC周辺機器や民生機器の需要増加に加え、ソフトウェア製品が伸長

(百万円)	21/3月期 上期 実績	22/3月期 上期 実績 (従来基準)	増減	主な増減理由	22/3月期 上期 実績 (収益認識基準)
アナログIC	20,259	16,864	△ 3,395	自動車・産業機器向けの減少	16,218
標準ロジック	681	21	△ 660		21
メモリーIC	1,950	2,737	+787		2,737
マイクロプロセッサ	3,009	2,584	△ 424		2,584
特定用途IC	80,555	79,333	△ 1,222	OA機器向けの減少	16,206
カスタムIC	2,157	3,487	+1,331	PC関連機器向けの増加	3,487
電子部品	10,339	19,059	+8,720	民生・自動車向け部品、 ソフトウェア製品の増加	16,636
合計	118,982	124,097	+5,115		57,900

2022年3月期 第2四半期 『デバイス事業』 用途別動向

従来基準

	動 向	
通信機器	→	前年並み
民生機器	→	娯楽機器向けの増加
自動車	→	電子制御装置向けの増加
コンピュータ&OA	→	前年並み
産業機器その他	→	産業用途向け半導体の減少



2022年3月期 第2四半期 『システム事業』 品目別売上高

■ 設備投資の回復により、産業機器・レーザー機器が伸長

(百万円)	21/3月期 上期 実績	22/3月期 上期 実績 (従来基準)	増減	主な増減理由	22/3月期 上期 実績 (収益認識基準)
航空宇宙機器	1,374	1,949	+575		1,930
産業機器	7,553	10,230	+2,676	電子部品組立検査装置の増加	9,552
レーザー機器	1,601	2,314	+713	半導体レーザーの増加	2,431
情報通信機器	491	683	+192		690
医用機器	7,266	8,083	+817	画像診断装置の増加	8,073
合計	18,285	23,260	+4,975		22,675

2022年3月期 第2四半期 貸借対照表の概要

(百万円)	21/3月期末 実績	21/9月期末 実績	前期末比 増減額	主な増減要因	
資産合計	127,006	141,275	+14,269		
流動資産	114,804	129,706	+14,902	現金及び預金	△ 3,160
				受取手形及び売掛金	△ 8,465
				商品及び製品	△ 7,838
				未収入金	+34,368
固定資産	12,202	11,569	△ 633	投資その他資産	△ 173
負債合計	81,966	94,579	+12,613		
流動負債	76,165	88,758	+12,593	支払手形及び買掛金	△ 10,776
				短期借入金	+8,252
				未払金	+14,392
固定負債	5,801	5,820	+19	退職給付に係る負債	+41
純資産合計	45,040	46,696	+1,656	利益剰余金	

中期経営計画の取組み状況

創業以来の **先見** と **先取** の精神のもと

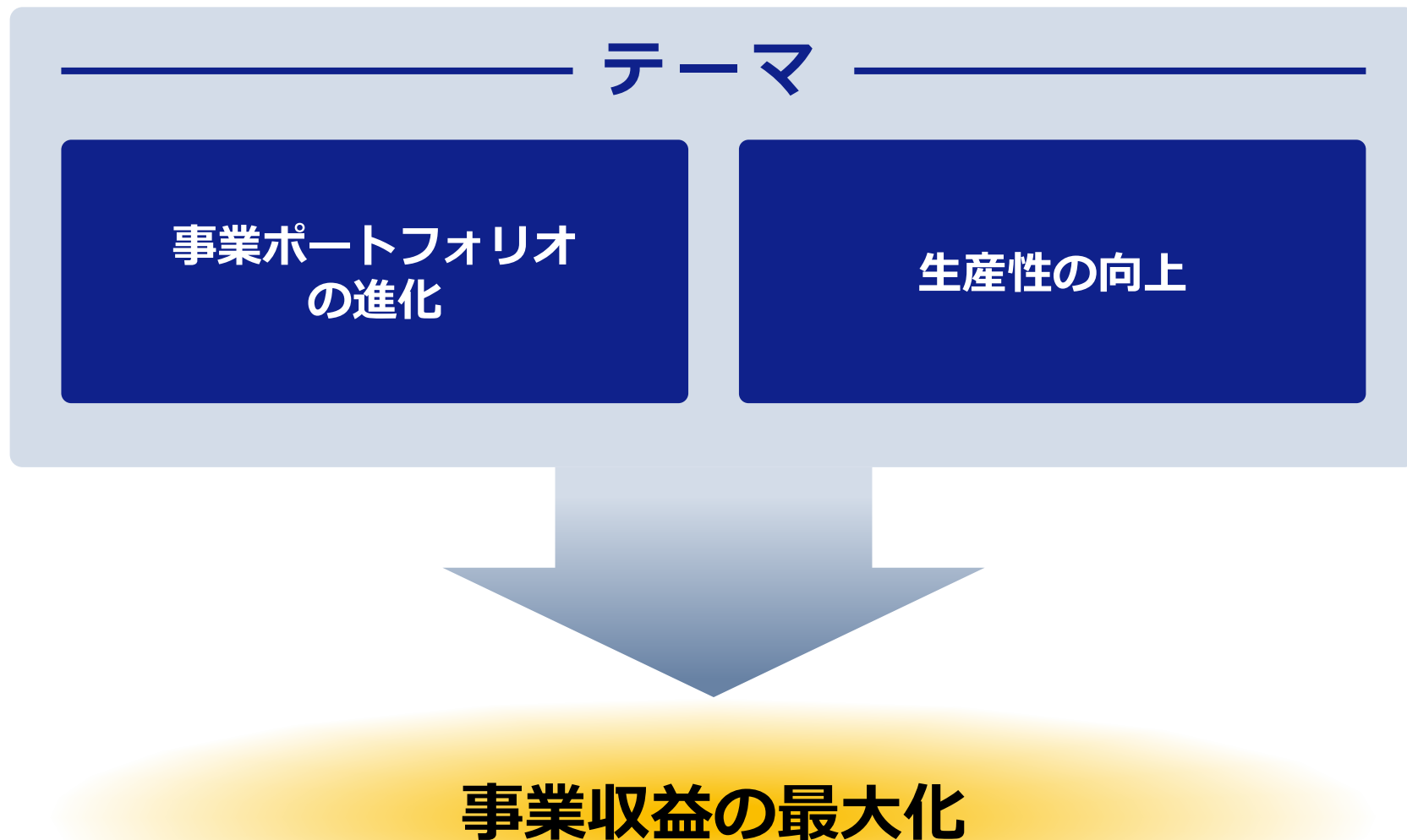
中期経営計画の取り組み (2019年度 ~ 2021年度)

新たな価値を創造するビジネスモデルの構築

成長市場に向けた事業開発の促進

持続可能な社会に貢献する取り組みの強化

デバイス事業の取り組み

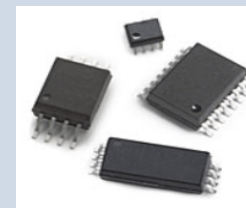


デバイス事業の重点施策と取り組み状況

1 高付加価値 ビジネスの推進

付加価値の高い商材やサービスで商権を拡大

- 既存仕入先の新規商権、新規仕入先製品が伸長
- 今後、更なる商材の発掘、商権の獲得を推進



2 成長市場での 事業拡大

A I ・ロボティクス ・介護など成長分野に注力

- アイオロス社 自律型 A I ロボットを介護施設へ導入済
- オシア社ワイヤレス給電など先端技術商材の提案を推進中



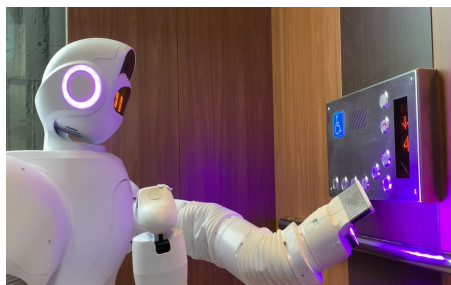
3 新たなビジネス モデルの構築

ソフトウェア販売など新たなビジネス形態を確立

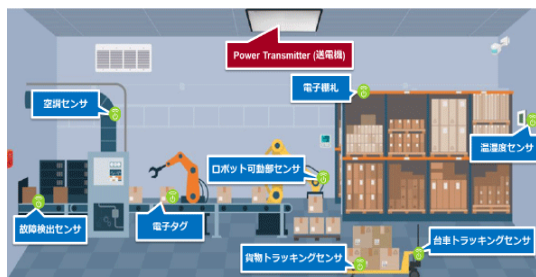
- サブスクリプション契約やライセンスビジネスを推進
- ソフトウェア事業を本格立上げ



デバイス事業の新規商材



Aeolus Robotics社
AI搭載自律型ロボット



Ossia社
無線給電技術Cotaのイメージ図



StethoMe社
電子聴診器

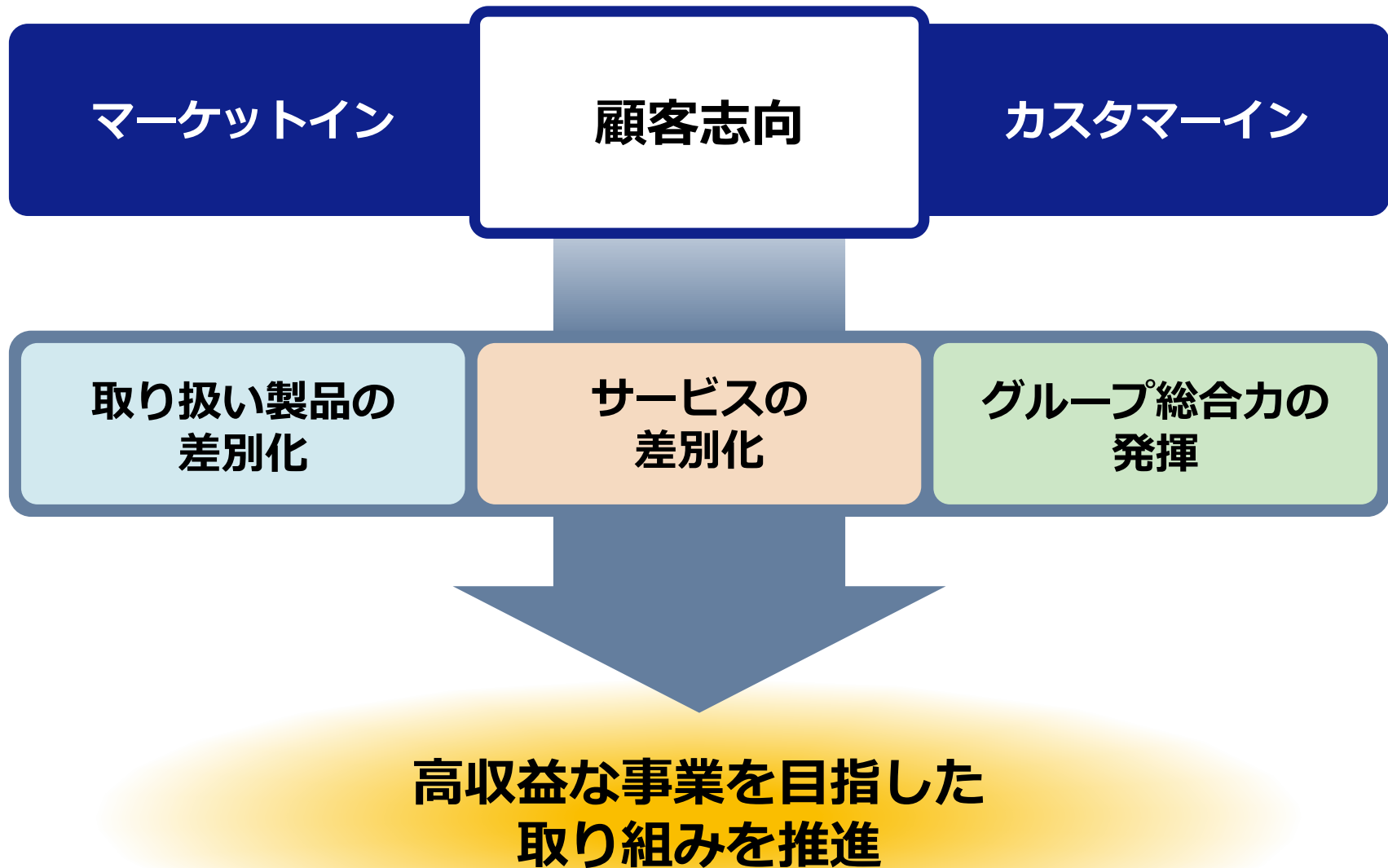


eYs3D Microelectronics社
ステレオ3Dカメラモジュール



ScaleFlux社
Computational Storage Drives

システム事業の取り組み



システム事業の重点施策と取り組み状況

1 航空宇宙機器

- 人工衛星・ロケット向け高信頼性部品の需要取り込みに注力
- フライトシミュレータに加え、ドライビングシミュレータを拡販中



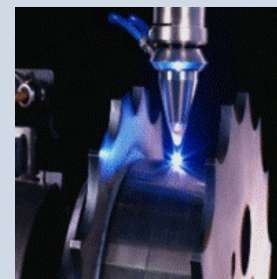
2 産業機器

- 先進的かつ高性能の組立・検査・解析装置の取扱いを拡充
- 工場設備のIoT化に貢献するソリューションに注力



3 レーザ機器

- 産業機器向けレーザの販売強化
- 自動車向けや医療機器向けなどへの応用提案を推進



システム事業の重点施策と取り組み状況

4 情報通信機器

- データセンター市場向け販売促進
- 5G・ローカル5Gの市場展開に合わせた商品ラインナップを拡充中



5 医用機器

- コロナウイルス関連商材など 新たな商材を拡充済
- サービスエンジニアリングの育成・強化を推進中



2022年3月期 業績予想の概要

2022年3月期 業績予想サマリ

(百万円)	21/3月期 (従来基準)		22/3月期 (従来基準)			前年同期比 (従来基準)		予想比 増減額	22/3月期 (収益認識基準)	
	実績	構成比	前回予想 (5/14時点)	今回予想 (10/29発表)	構成比	金額	%		今回予想 (10/29発表)	構成比
売上高	289,283	100.0%	238,000	274,000	100.0%	△ 15,283	-5.3%	+ 36,000	163,000	100.0%
デバイス事業	242,050	83.7%	188,000	222,000	81.0%	△ 20,050	-8.3%	+ 34,000	112,000	68.7%
システム事業	47,233	16.3%	50,000	52,000	19.0%	+ 4,767	10.1%	+ 2,000	51,000	31.3%
売上総利益	16,217	5.6%	17,000	19,200	7.0%	+ 2,983	18.4%	+ 2,200	19,200	11.8%
販管費	15,193	5.3%	13,800	14,200	5.2%	△ 993	-6.5%	+ 400	14,200	8.7%
営業利益	1,023	0.4%	3,200	5,000	1.8%	+ 3,977	388.8%	+ 1,800	5,000	3.1%
営業外収益	160	0.1%	350	300	0.1%	+ 140	87.5%	△ 50	300	0.2%
営業外費用	1,149	0.4%	550	800	0.3%	△ 349	-30.4%	+ 250	800	0.5%
経常利益	33	0.0%	3,000	4,500	1.6%	+ 4,467	13536.4%	+ 1,500	4,500	2.8%
特別利益	31	0.0%	-	55	0.0%	+ 24	77.4%	+ 55	55	0.0%
特別損失	2,603	0.9%	-	5	0.0%	△ 2,598	-99.8%	+ 5	-	-
親会社株主に帰属 する当期純利益	△ 2,133	-0.7%	1,900	2,900	1.1%	+ 5,033	-	+ 1,000	2,900	1.8%

■ ポイント（前年対比：従来基準ベース）

売上高	(デバイス事業) 通信機器向けの減少を見込む (システム事業) 産業機器・レーザ機器の増加を見込む
売上総利益	付加価値の高い商材の取扱い増加により増益を見込む
営業利益	売上総利益の増加および人件費を中心とした販管費の減少により増益を見込む

2022年3月期 『デバイス事業』 品目別売上高予想

■ 電子部品やPC関連機器向けICの販売伸長を見込むものの、通信機器向けICが減少

(百万円)	21/3月期 実績	22/3月期 予想 (従来基準)	22/3月期 予想 (従来基準)	増減	主な増減理由	22/3月期予想 (収益認識基準)
アナログIC	34,791	36,372	32,176	△ 2,615	自動車・産業機器向けの減少	32,176
標準ロジック	758	74	42	△ 716		42
メモリーIC	5,018	5,623	5,584	+565		5,584
マイクロプロセッサ	5,612	7,719	3,473	△ 2,139	産業機器・自動車向けの減少	3,473
特定用途IC	165,057	106,894	135,907	△ 29,150	通信機器向けの減少	30,633
カスタムIC	4,550	1,155	6,792	+2,241	PC関連機器向けの増加	6,792
電子部品	26,264	30,162	38,025	+11,761	民生・産業機器向け部品、ソフトウェア製品の増加	33,299
合計	242,050	188,000	222,000	△ 20,052		112,000

2022年3月期 『システム事業』 品目別売上高予想

- 設備投資需要の回復で、産業機器やレーザー機器の増加を見込む

(百万円)	21/3月期 実績	22/3月期予想 (従来基準)	増減	主な増減理由	22/3月期予想 (収益認識基準)
航空宇宙機器	4,355	5,497	+1,142	人工衛星向け高信頼性部品の増加	5,429
産業機器	18,207	20,547	+2,339	電子部品の組立・検査装置の増加	19,625
レーザー機器	3,642	5,584	+1,942	半導体レーザー・レーザー加工装置の増加	5,584
情報通信機器	1,820	2,393	+572	データセンター向け通信機器の増加	2,392
医用機器	19,208	17,980	△ 1,228	医用機器保守の減少	17,970
合計	47,233	52,000	+4,767		51,000

株主還元

株主還元

■ 配当方針

配当性向 連結30%以上を目安として決定

■ 配当予想

	21/3月期	22/3月期 (予想)
1株当たり年間配当金(円)	16.00	30.00
中間配当	8.00	10.00
期末配当	8.00	20.00
配当性向(%)	—	27.0%

参考資料

企業概況

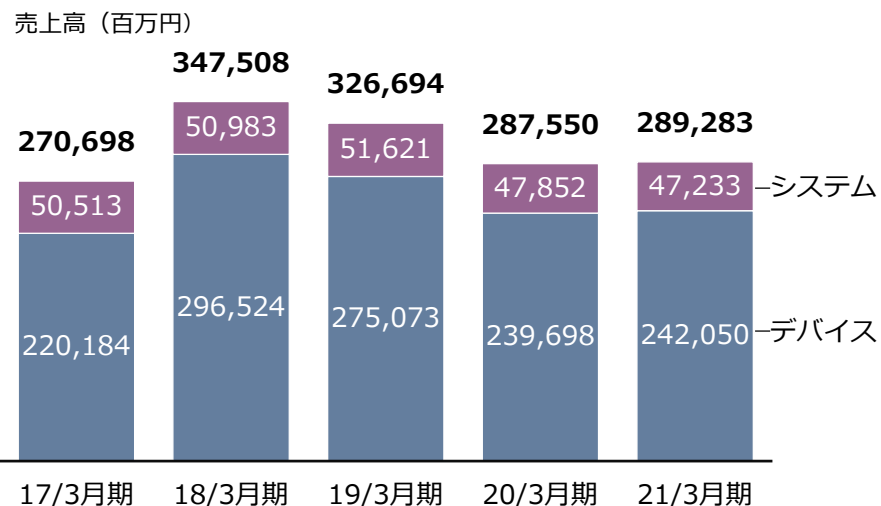
会社概要

創 業	1844年（弘化元年）
設 立	1947年（昭和22年）7月
所 在 地	東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号
資 本 金	62億1,450万円
決算期日	3月31日
代 表 者	代表取締役社長 飯野亨
売 上 高	連結 2,892億円（2021年3月期） 単体 2,374億円（2021年3月期）
従業員数	連結 1,145名（2021年3月末） 単体 613名（2021年3月末）
株式上場	東京証券取引所 市場第一部（コード:7537）

事業領域

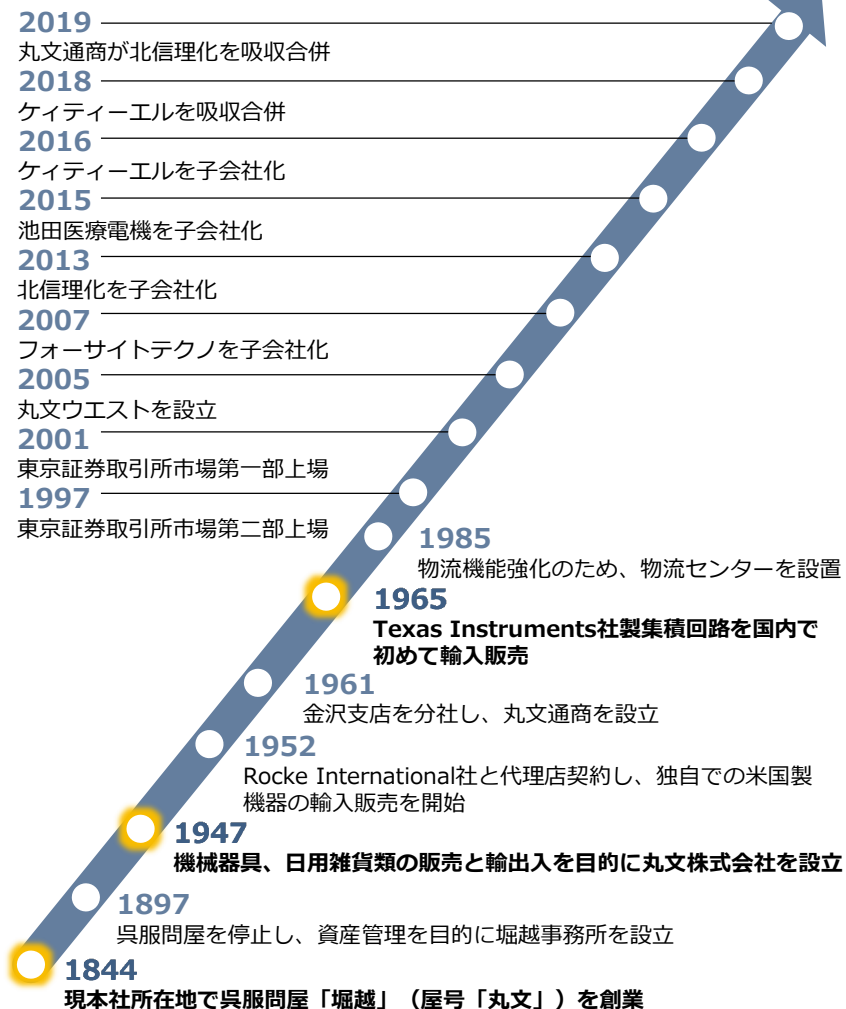
デバイス事業	システム事業
<ul style="list-style-type: none">半導体電子部品	<ul style="list-style-type: none">航空宇宙機器産業機器レーザー機器情報通信機器医用機器

連結売上高の推移

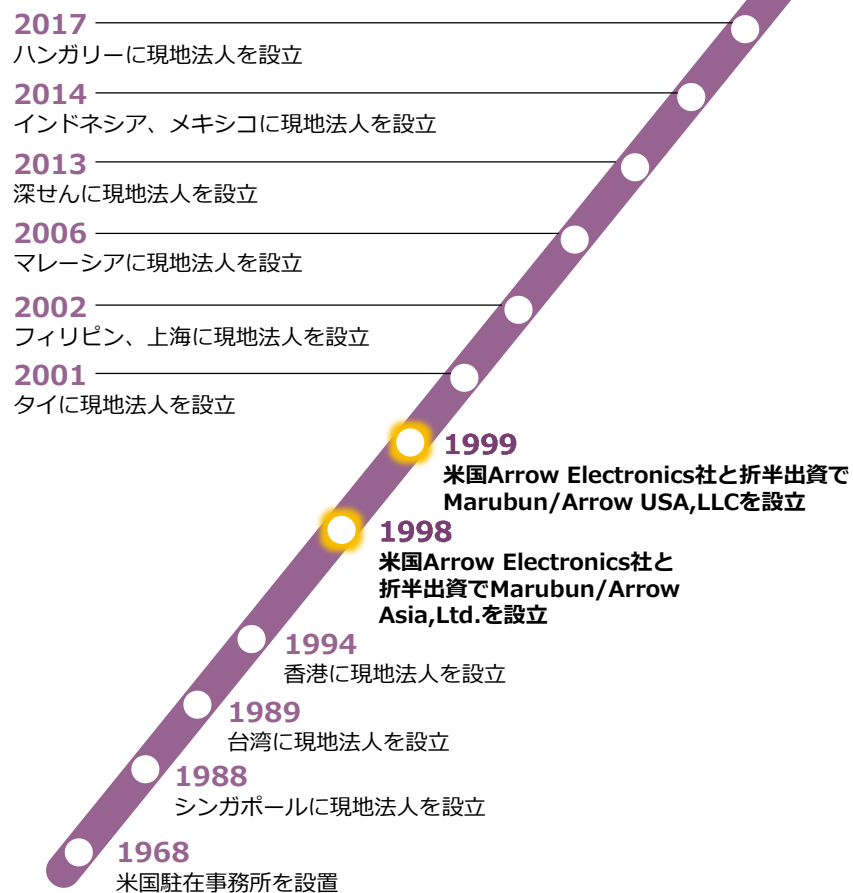


沿革

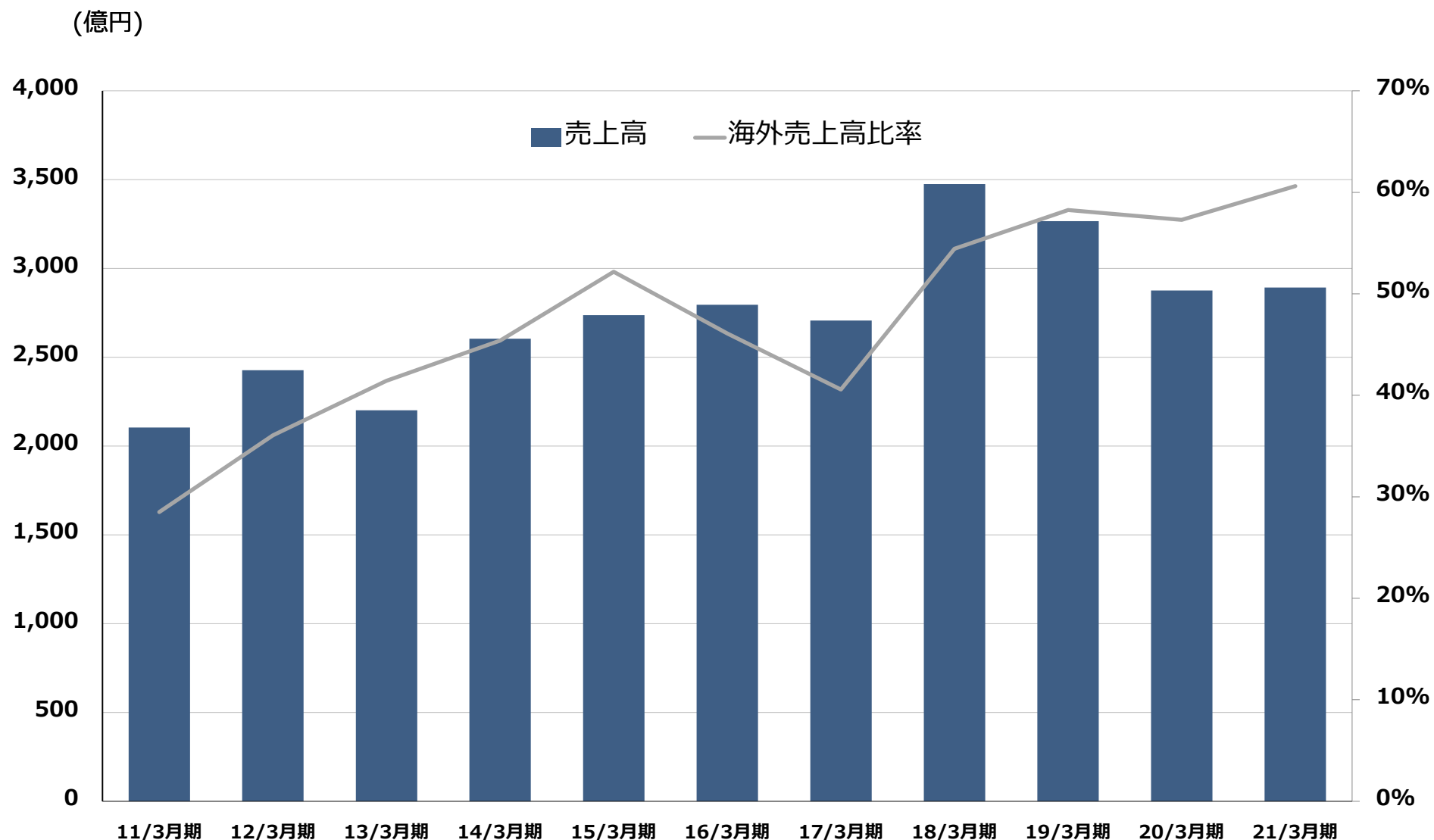
国内



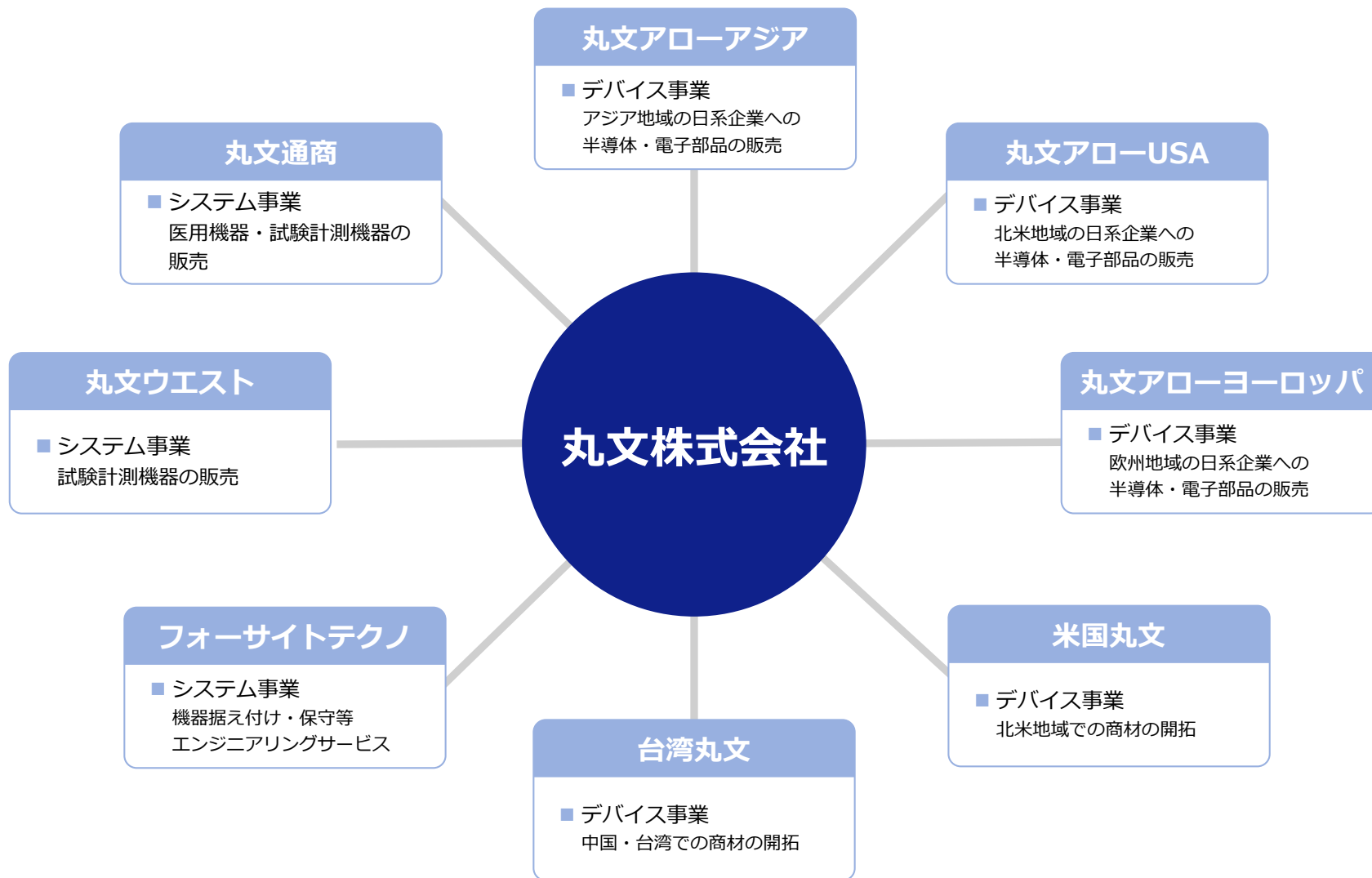
海外



中長期トレンド（売上高・海外売上高比率）

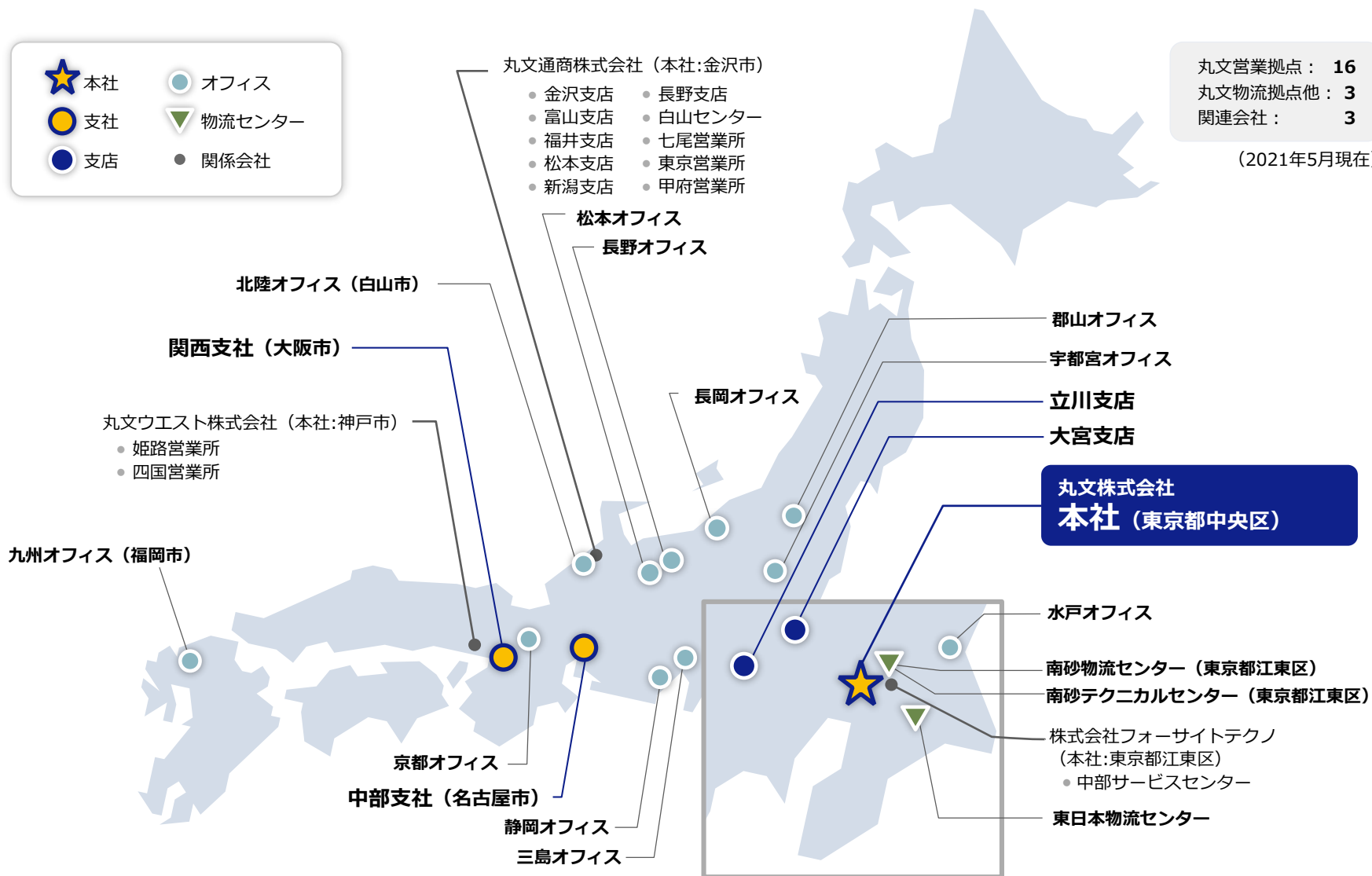


関係会社

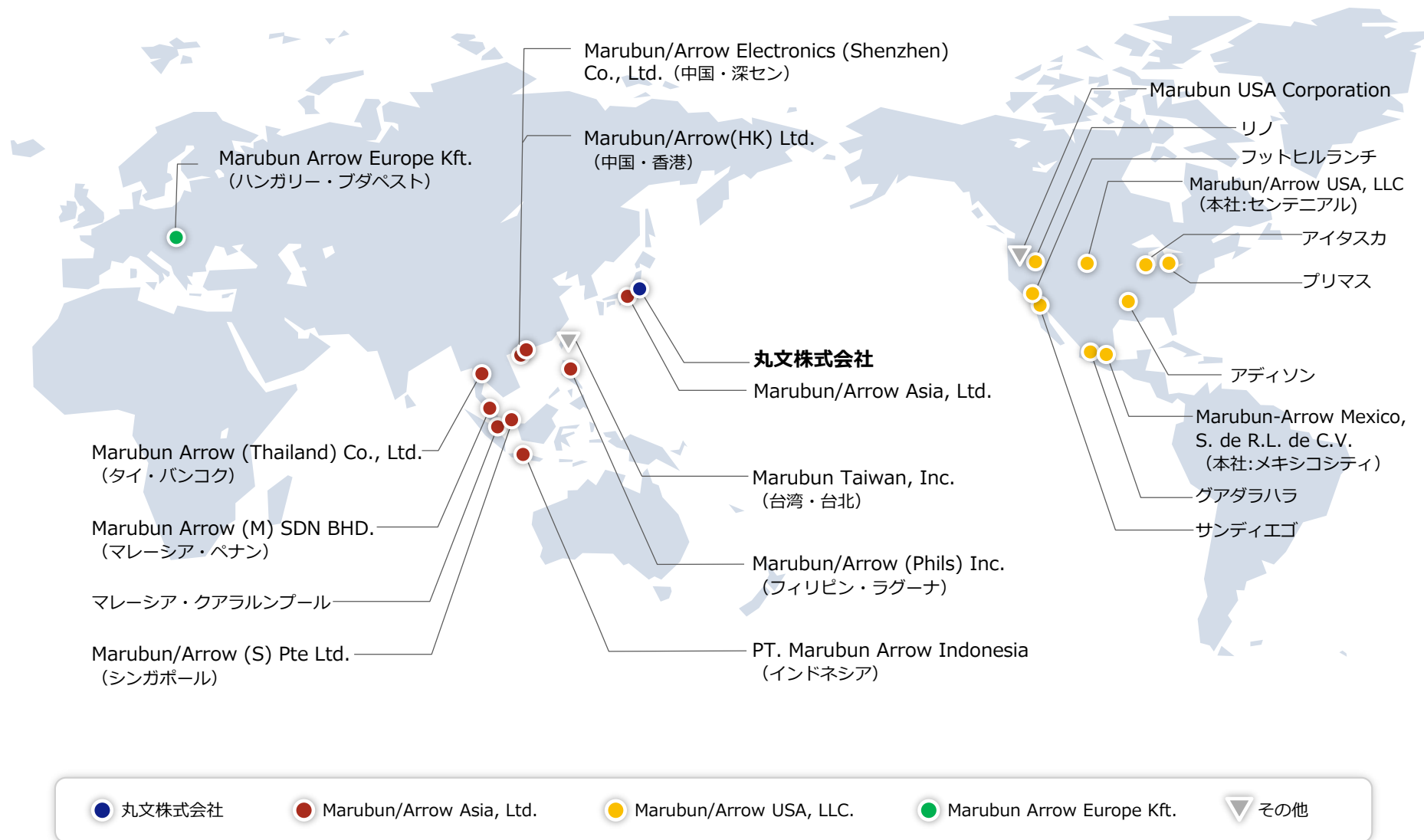


国内拠点

★ 本社	○ オフィス
● 支社	▽ 物流センター
● 支店	● 関係会社



グローバルネットワーク



(2021年5月現在)

グローバルサポート

- アローエレクトロニクスとの協業
- 丸文アローによるワールドワイドで日本品質のサポート

豊富なラインカードと製品相互のシナジー

- 国内外の競争力のあるサプライヤをラインナップ
- 標準品からカスタムまで幅広い取扱製品

提供価値

システムソリューション

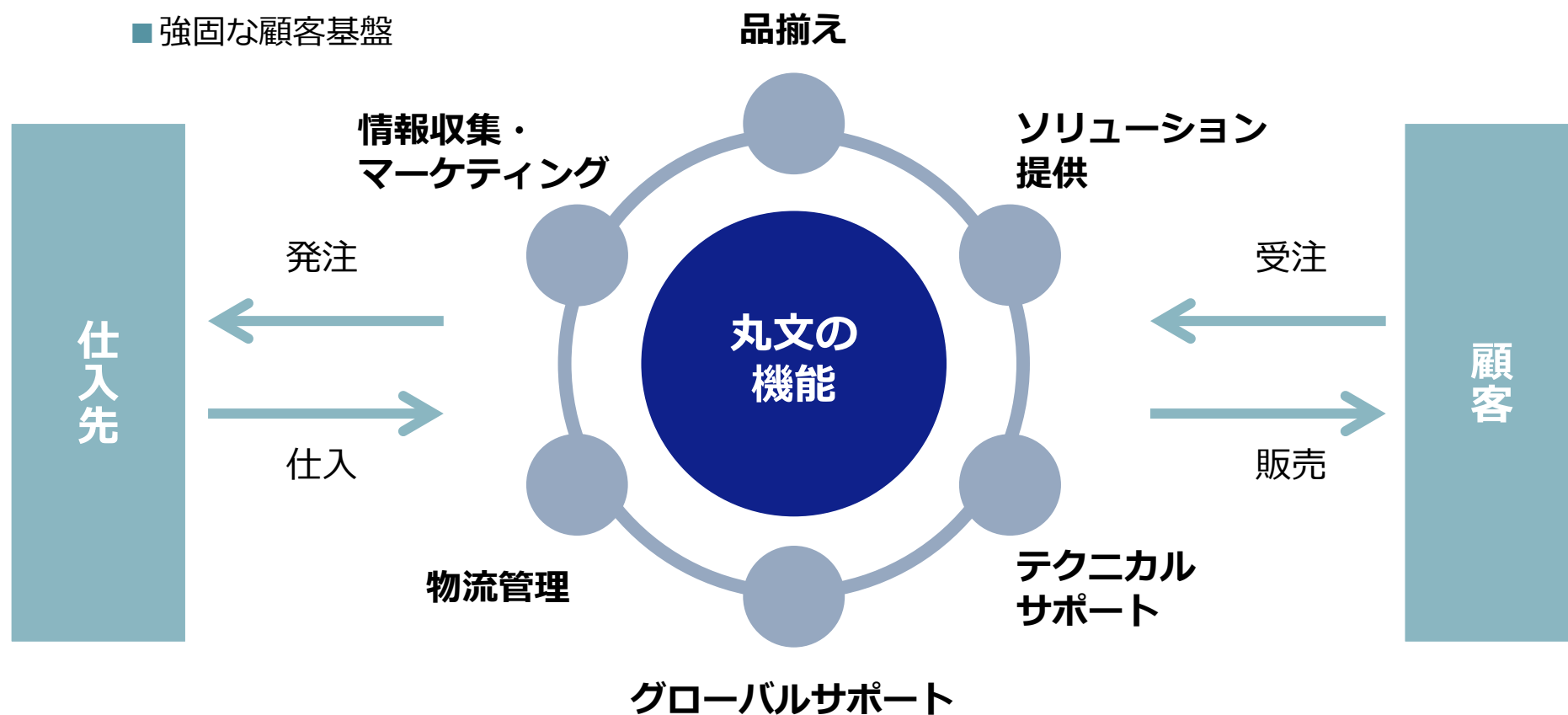
- 高い専門性をもつ強力な技術サポート体制
- 3rdパーティ、モジュールメーカ、EMS/ODM等との協業関係

長年にわたる取引で培われた強固な顧客基盤

- 国内電子機器メーカーを中心とする強固な顧客基盤

デバイス事業：特徴と強み

- 海外サプライヤを中心とした豊富な品揃え
- 米国アロー社との提携によるグローバルネットワーク
- 高度な技術力をもとにしたソリューション提案力
- 強固な顧客基盤



デバイス事業：グループ会社概要

社名	住所	設立年月	出資比率	事業内容
Marubun USA Corporation	California, U.S.A.	1983年10月	100%	丸文アローUSAの持株会社
Marubun Taiwan, Inc.	Taipei, Taiwan	1989年11月	100%	台湾製デバイスの仕入販売
Marubun/Arrow Asia, Ltd.	British Virgin Islands	1998年10月	50%	丸文アローシンガポール、丸文アロー香港の持株会社
Marubun/Arrow (S) Pte Ltd.	Pereira Road, Singapore	1988年3月	50%	
Marubun/Arrow (HK) Ltd.	Hong Kong, China	1994年8月	50%	
Marubun Arrow (Thailand) Co., Ltd.	Bangkok, Thailand	2000年10月	50%	
Marubun/Arrow (Phils), Inc.	Laguna, Philippines	2001年10月	50%	
Marubun Arrow (M) SDN BHD	Penang, Malaysia	2006年6月	50%	海外進出した日系企業への 半導体・電子部品の仕入販売
Marubun/Arrow Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.	Shenzhen, China	2013年6月	50%	
PT. Marubun Arrow Indonesia	Jakarta, Indonesia	2014年4月	50%	
Marubun/Arrow USA, LLC*	Delaware, U.S.A.	1998年11月	50%	
Marubun-Arrow Mexico, S. de R.L. de C.V.*	MexicoCity, MEXICO	2014年9月	50%	
Marubun Arrow Europe Kft.*	Budapest, Hungary	2017年11月	50%	

* Marubun/Arrow USA、Marubun-Arrow Mexico、Marubun Arrow Europe Kft.は持分法適用の関連会社です。

デバイス事業：主要取扱い製品

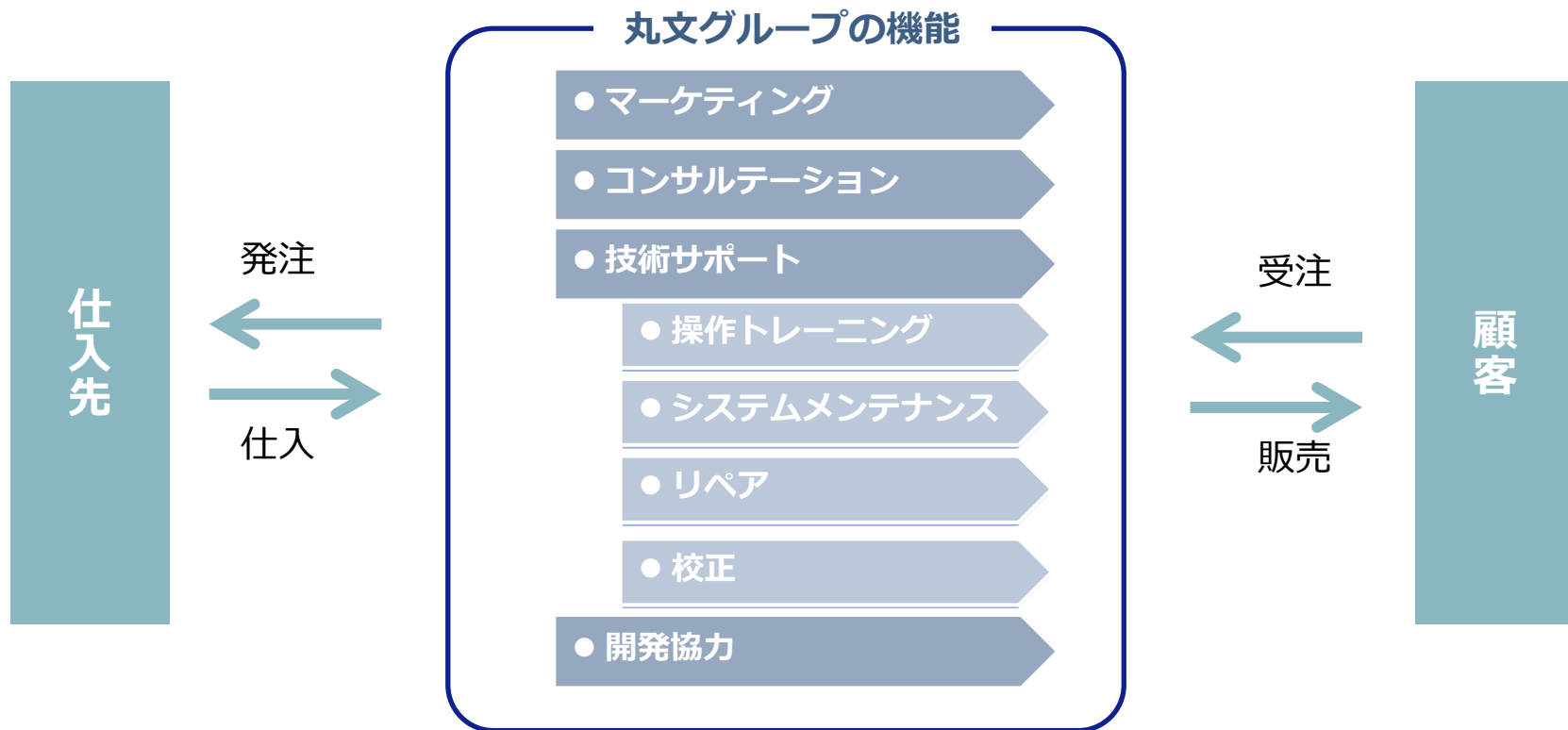
品目 主要仕入先 (アルファベット順)	半 導 体					電子部品		
	アナログIC	メモリーIC	マイクロプロセッサ	特定用途IC	カスタムIC	電子部品	電子機器	その他
	標準アナログ、センサー、ディスクリートなど	フラッシュ、DRAMなど	MPU、MCU、DSPなど	ASSP、LEDなど	カスタム、ASIC、FPGAなど	ディスプレイ、水晶振動子、コネクタ・スイッチ・基板など	ロボット、IoT機器、医療機器など	パワーサブライ、ボードPC、ソフトウェア、IPライセンスなど
エイブリック	●	●						
Afero				●			●	●
旭化成エレクトロニクス	●		●	●	●			
ATP		●						
Autotalks				●				
Broadcom	●			●	●	●	●	●
Cree	●							
Cypress※1		●	●	●				
Eink						●		
InvenSense	●							
ISSI	●	●		●				
GOWIN					●			
Littelfuse	●					●		
Maxim	●		●	●		●		
Microchip	●	●	●	●	●	●		
Molex						●		
MPS※2	●							
Nuvoton	●		●	●	●			
Qorvo	●			●				
セイコーエプソン			●	●	●	●	●	
SEMTECH	●			●				
TE Connectivity	●					●		
VANTIQ								●
VICOR								●
VISHAY	●			●				●
Western Digital		●						

*1:Cypress Semiconductor, An Infineon Technologies Company *2:Monolithic Power Systems,Inc.

Aeolus	AI搭載ロボット	Acconeer	ミリ波レーダモジュール	FINSix	超小型電力モジュール
Nanoramic	カーボンナノチューブ	OSSIA	ワイヤレス給電技術ライセンス	StethoMe	電子聴診器

システム事業：特徴と強み

- ハイエンド市場で、技術優位性の高い電子機器・部品を提供
- システム提案から据え付け保守まで、一貫した高レベルの技術サポート



システム事業：グループ会社概要

社名	本社	設立年月	出資比率	事業内容
丸文通商株式会社	石川県金沢市	1961年3月	100%	医用機器および試験計測機器の仕入販売・修理・メンテナンス
丸文ウエスト株式会社	兵庫県神戸市	2005年5月	100%	試験計測機器の仕入販売
株式会社フォーサイトテクノ	東京都江東区	1999年3月	51%	システム製品の修理・メンテナンス、エンジニアリングサービス

システム事業：主要取扱い製品①

分野	主要取扱商品	主要仕入先
航空宇宙機器	宇宙関連機器 計測・各種センサ	日本ベーカーヒューズ（株）、 Comtech Telecommunications Corp.、PCB Piezotronics, Inc
	航空関連機器 高周波電子機器	Bird Technologies、CPI Inc.、Textron Systems Corporation
産業機器	検査装置 製造装置・組立装置	アキム(株)、Ansible Motion Limited、セイコーエプソン(株)、(株)FUJI、(株)ユー・エイチ・システム
	組込ソリューション	ADLINK Technology Inc.、Aitech Defense Systems, Inc.、 Artesyn Embedded Technologies Inc.、DFI、Gorilla Technology Inc.
レーザー機器	半導体レーザー レーザー加工機	Amplitude、Laserline GmbH.、nLIGHT, Inc.、NUTECH GmbH
	光学機器	Excelitas Technologies Corp.、First Sensor AG、Luminus, Inc.、United Power Research Technology Corp.、ViALUX GmbH、Young Optics Inc.
情報通信機器	RF・光通信 測位タイミング	Athonet S.R.L.、Calnex Solutions Ltd.、EXFO Inc.、 Microchip Technology Inc.、PCTEL, Inc.、Septentrio N.V.、Spirent Communications
医用機器	画像診断機器	コニカミノルタジャパン(株)、(株)島津製作所、シーメンスヘルスケア(株)、 富士フイルムヘルスケア(株)
	人工透析機器	旭化成メディカル(株)、(株)カネカメディックス、日機装(株)、
	臨床検査機器	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)、ベックマンコールター(株)

システム事業：主要取扱い製品②

航空宇宙機器



BEI Sensors社
高信頼性部品



CPI社
マイクロ波電子管

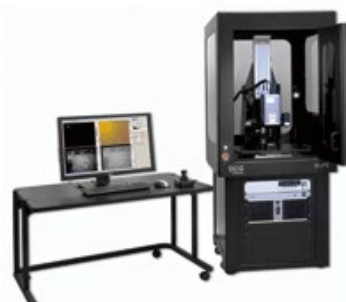
産業機器



島津製作所
ガスクロマトグラフ質量分析計



アキム
電子部品組立装置



FEI社
赤外線発熱解析装置



FUJI
大気圧プラズマ表面改質装置

システム事業：主要取扱い製品③

レーザ機器



nLIGHT社
組み込み用半導体レーザ



Laserline社
レーザー加工装置

情報通信機器



Microchip社
ネットワークタイムサーバー



Spirent社
GNSSシミュレータ

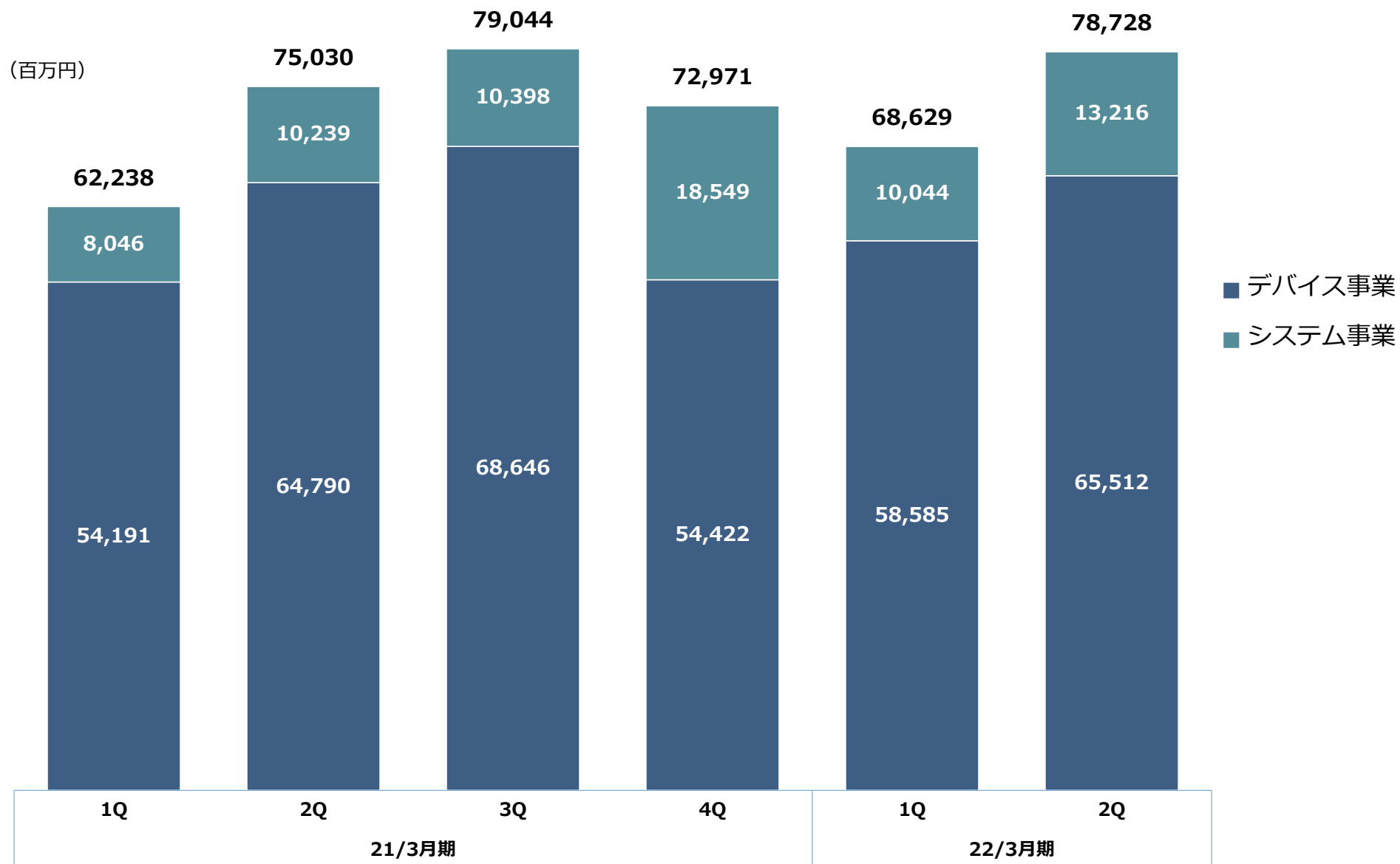
医用機器



シーメンスヘルスケア社
X線CT装置

業績四半期推移（事業別売上高）

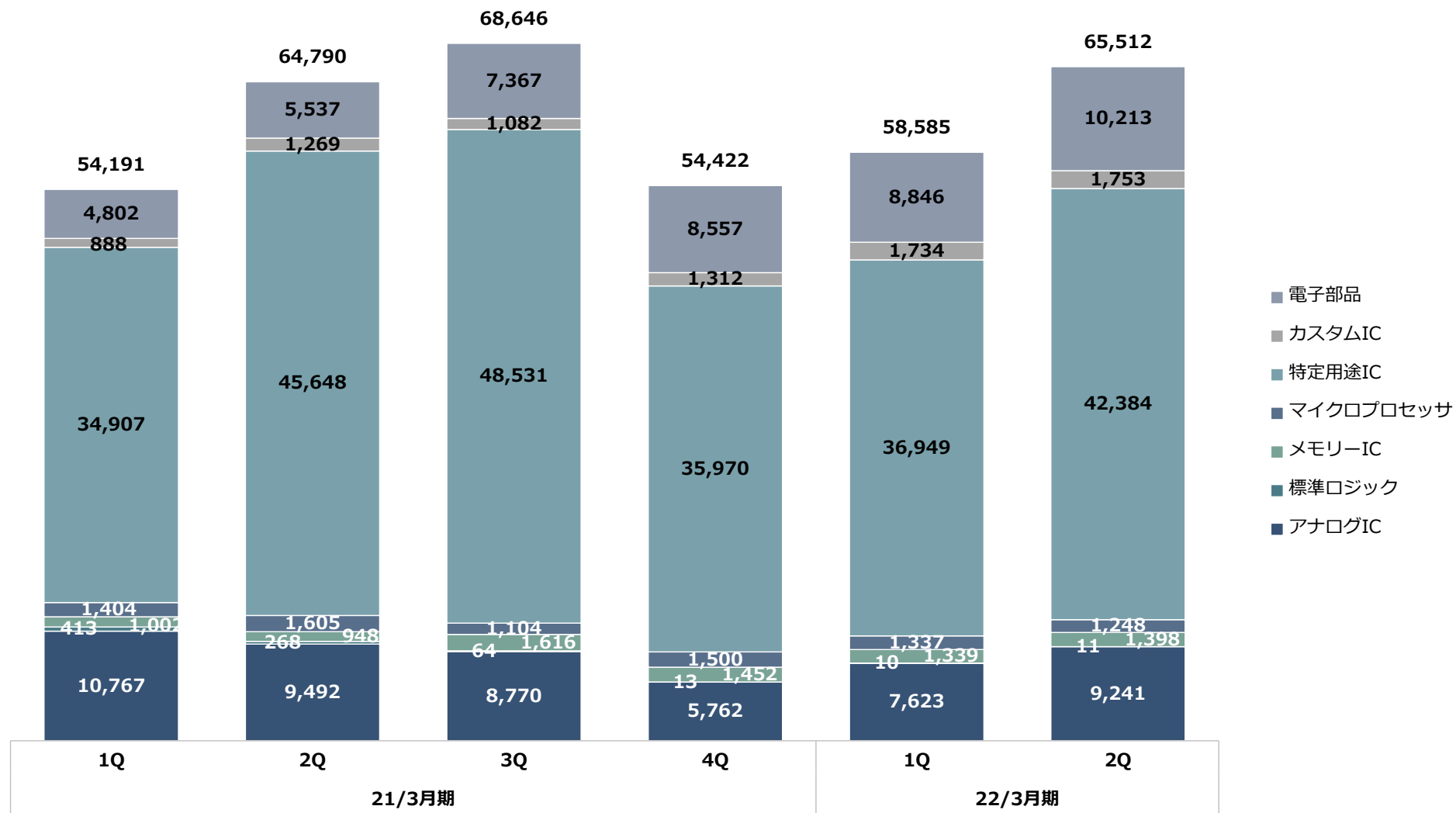
従来基準



業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高）

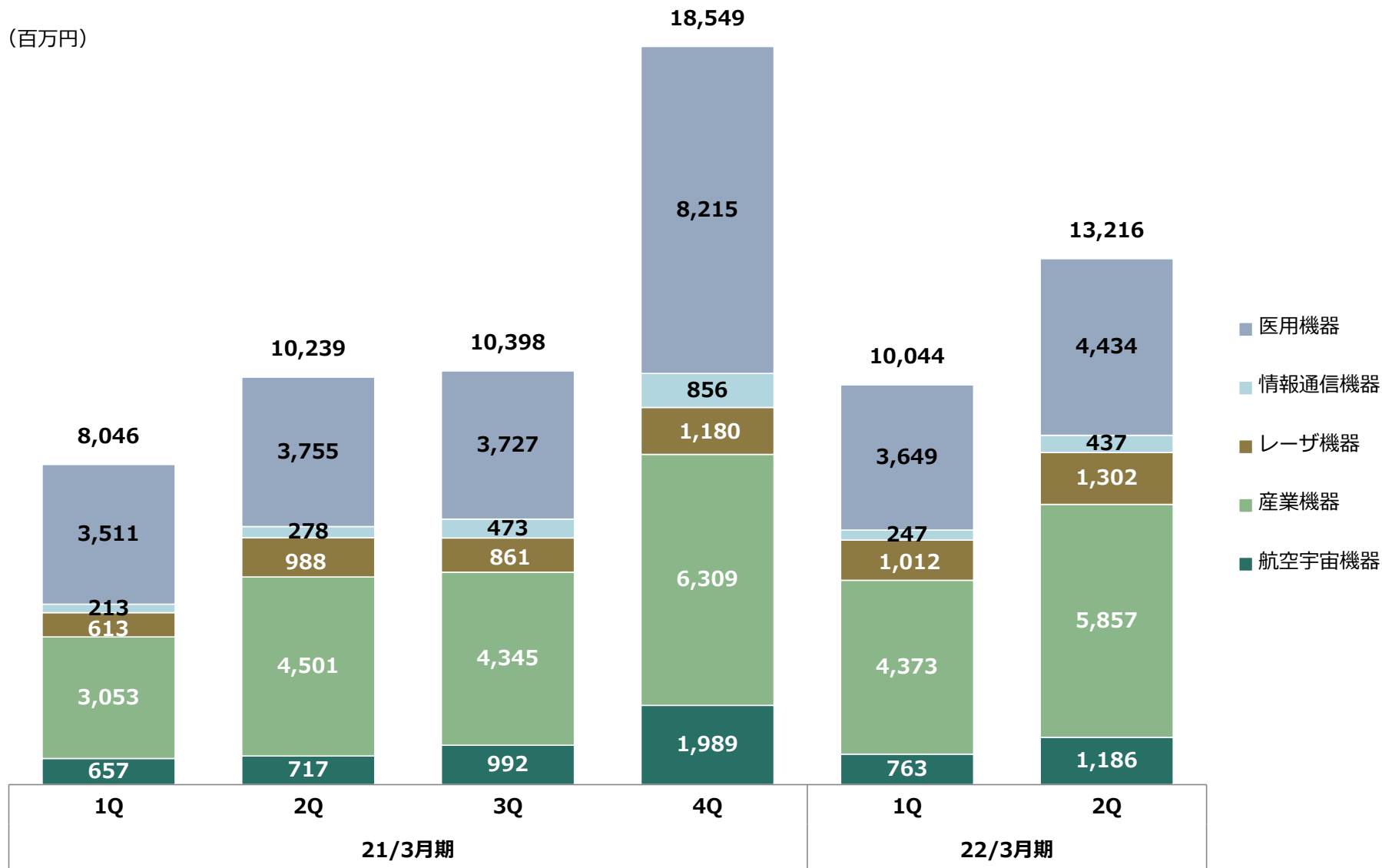
従来基準

(百万円)



業績四半期推移（システム事業：品目別売上高）

従来基準



本資料お取扱い上のご注意

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な重要な要素により異なる可能性がありますことをご承知おきください。

本資料に関するお問い合わせ

丸文株式会社 経営企画部

E-mail ir@marubun.co.jp